

一年一度 本届更加异彩纷呈 欢迎光临

第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会

邀 请 书

《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》定于 2017 年 11 月 8 日至 11 月 10 日在广东省东莞市《尼罗河国际大酒店》召开。

近年来，中国覆铜板上下游产业链积极协同创新，在大力推进发展覆铜板制造技术方面，取得了可喜的成就，多种新产品已经研发或量产，许多新技术、新材料得到了应用。在迅速发展的 5G、汽车电子等市场需求的驱动下，覆铜板及其材料在实现高频、高速、高可靠性的过程中技术得到革命性突破。近期，中国覆铜板业又有了哪些新热点、覆铜板市场、技术的发展趋势如何？覆铜板用关键原材料技术的发展方向是什么？

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会、中国电子电路行业协会基板材料分会、国家电子电路基材工程技术研究中心共同于 2017 年 11 月 8 日至 11 月 9 日在广东省东莞市“尼罗河酒店”组织召开《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》。本届研讨会的主题是“新形势下覆铜板技术的持续创新与协同发展”。本届大会是新形势、新市场发展下我国覆铜板行业的一次高端技术论坛和交流盛会。大会邀请了海内外覆铜板行业及其上下游行业专家、技术人员，对覆铜板制造的新技术、新工艺、新材料、新设备、新标准及未来覆铜板市场、技术的发展趋势，进行深入广泛的研讨。同时，为鼓励覆铜板行业工程技术人员积极参与征文、提升研讨会论文技术水平，本届研讨会特增设了评选与颁发“CCLA 优秀论文奖”的环节。

在《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》召开的同期，中国电子材料行业协会覆铜板材料分会、安徽统唯新材料科技有限公司（原安徽鑫柏格电子股份有限公司）定于 2017 年 11 月 10 日上午，在东莞市“尼罗河酒店”召开《第四届中国挠性覆铜板企业联谊会》。本届 FCCL 企业联谊会特邀了行业知名专家及企业高层领导作精彩报告，并安排参会代表们共同研讨 FCCL 行业及产业链的热门话题，希望能够促进我国 FCCL 产业及 FCCL 市场、技术的发展。

主办单位及联络资讯：

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）

王晓艳 029-33335234

中国电子电路行业协会基板材料分会（CPCA）

李 琼 021-54179011-605

国家电子电路基材工程技术研究中心

王 猛 0769-88986318-7277

13620025522

协办单位:

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会 (CCFA)
中国电子材料行业协会电子精细化工与高分子材料分会 (ECMA)
IPC—国际电子工业联接协会
广东省线路板行业协会 (GPCA)
深圳市线路板行业协会 (SPCA)
台湾电路板协会 (TPCA)

赞助单位: (征集中)

广东广山新材料股份有限公司	安徽统唯新材料科技股份有限公司
南亚新材料科技股份有限公司	山东圣泉新材料股份有限公司
广东同宇新材料有限公司	南通凯迪自动机械有限公司
江苏瀚高科技有限公司	南通图海机械有限公司
淄博科尔本高分子新材料有限公司	安徽大松树脂有限公司
成都科宜高分子科技有限公司	

会议日程: (会议日程表附后)

《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》: 2017年11月8日~9日。8日全天报到, 9日(8:00~18:00)全天报告, 10日疏散。

《第四届中国挠性覆铜板企业联谊会》: 2017年11月10日(8:00~12:00)。

宣传媒体:

杂志: 《覆铜板资讯》、《电子铜箔资讯》、《印制电路资讯》。

网站: 中国覆铜板信息网 www.chinaccl.cn; 中国电子铜箔资讯网 www.chinaccf.com.cn; ECMA网 www.ecma.org.cn; PCB网城 www.pcbcity.com.cn。

会议费用:

会员单位代表: 已交会员费单位收会务费、资料费、餐饮费 1300 元/人 (未交会员费的单位 1500 元/人); 非会员单位代表: 收会务费、资料费、餐饮费 1800 元/人。参会代表可提前将会务费用汇至协会账户, 如参会人员有变动, 可随后退费或报到现场补交。

住宿: 参会代表按会议优惠价自行与酒店联系预定房间并在酒店前台办理 (标间/单间 288 元/每日, 含双份早餐), 费用自理。

付款方式:

帐户: 中国电子材料行业协会

开户银行:工行北京香河园支行

账号: 0200 0191 0900 0125 724

注: 提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组, 收到汇款后即可开票邮寄, 汇款时请附言“覆铜板会议会务费”, 以便区分; 现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组, 以便会议结束后及时开票邮寄。

会议地址: 广东东莞市“尼罗河国际大酒店”(东莞市万江区万江路南 10 号新华南 MALL F 区, 电话: 0769-22706666)。

会议酒店交通指南:

1、飞机: 广州白云机场: 乘机场大巴到东莞(万江)城市候机楼, 此处距尼罗河国际大酒店 200 米。单程约 80 分钟, 参考票价约 60 元。(乘车地点: 到达厅 A 区 A5 号门, B 区 B6 号门, 末班车为 19:00), 若到达广州机场超过 19:00 可坐机场大巴到南城国际航空港(末班车为 23:50), 打车去酒店;

深圳宝安机场: 乘机场大巴到东莞(万江)城市候机楼, 此处距尼罗河国际大酒店 200 米。单程约 80 分钟, 参考票价约 46 元。(乘车地点: 到达厅大厅中心坐电梯到一楼机场车站, 末班车为 21:00)

2、高铁: 广州南站: 广州南乘坐大巴直达东莞市汽车总站, 东莞市汽车总站距离尼罗河国际大酒店 1500 米, 步行约 15 分钟。虎门高铁站: 坐地铁 2 号线到鸿福路站, 打车去酒店。

3、火车: 东莞站(石龙): 坐地铁 2 号线到鸿福路站, 打车去酒店。东莞东站(常平): 乘坐公交快线 3 路(东莞东火车站-市汽车总站), 经过 19 站(总计 58 公里, 公交车约 3 小时), 在市汽车总站下车, 打车或步行 1500 米到达尼罗河国际大酒店。

4、汽车: 东莞市汽车总站: 乘坐公交 LG1/53/28/K5/L2/L3, 经过 1 站, 在华南摩尔下车, 步行约 400 米到达尼罗河国际大酒店。

酒店预订指南: 根据会务事先安排, 凡参此会代表办理住房预订事宜时, 需与本酒店的女士联系, 可提供房间优惠价格, 联系电话: 13543775422。

会务组联络方式:

联系人: 王晓艳 13609146084 , 029-33335234 , 13369111960

传真: 029-33335234

E-mail: ccla33335234@163.com

《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》组委会



《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》 会议回执

单位名称					订房数量	
代表姓名	职务	手机	电话	E-mail	单人间	双人间
开票信息： 名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号：						
注意	1、房源有限，计划在尼罗河酒店住宿的代表，务请尽快自行与酒店联系预订房间！与酒店联系时请报覆铜板行业协会，即可享受优惠价格。酒店预定房间联系人：邓玲 13543775422。 2、请参会代表准确填写回执表各项信息，将回执于10月30日前传真至029-33335234或发至ccla33335234@163.com。了解研讨会最新动态请登录： www.chinaccl.cn ，或者直接联系会务组。					

11月9日会议日程表

时间	报告地点、报告人及报告题目	主持人
1楼《会议厅2》		
8:00 ~ 12:00	CCLA 理事长 张东：致开幕词	张 东
	CPCA 领导致词	
	广东生益科技股份有限公司董事长 刘述峰： 打造跨学科面向市场的电子电路基材工业研究院	
	颁发优秀论文奖（获奖人员合影留念）	
	广东生益科技股份有限公司总工程师 曾耀德：高速材料性能与技术发展	祝大同
	中国电子科技集团公司第14研究所高级工程师 杨维生：我国微波 CCL 发展前景及技术瓶颈突破	
	中国科学技术信息研究所副研究馆员 刘 华：国家工程技术图书馆的资源与服务	
	广东生益科技股份有限公司工程师 介星迪：可降解、可回收的新型覆铜板的研究开发	
广东广山新材料股份有限公司董事长 潘庆崇：高频高速通信之材料篇		
12:00~ 13:30	自助午餐（一楼西餐厅）	王晓艳
一楼《会议厅10》		
13:30~ 17:30	江苏联瑞新材料股份有限公司副总经理 曹家凯：填料高填充技术的研究进展	师剑英
	中国地质大学材料与化学学院教授 曾 鸣： 高频低介电性羧基化石墨烯/苯并噁嗪纳米复合树脂的制备与性能研究	
	国家电子电路基材工程技术研究中心工程师 杨 虎： 一种多层板用无卤高 Tg 高 CTI 覆铜板	
	陕西泰信电子科技有限公司高级工程师 王金龙： 介电常数大于 3.5 的微波电路用覆铜箔板的研制	
	苏州生益科技有限公司工程师 马 建： 关于苯乙烯-马来酸酐-马来酰亚胺衍生物在覆铜板中的应用研究	
	浙江华正新材料股份有限公司工程师 应雄锋：一种低热阻可折弯 PI 型铝基板的开发	
	陕西生益科技有限公司总工程师 师剑英：浅析高频覆铜板的开发要点	
一楼《会议厅1》		
13:30~ 17:30	DIC 研发主任 林弘司(Koji Hayashi)： Development of Active Ester for Low Loss / High Speed CCL	杨中强
	法国阿科玛嵌段聚合物全球产品总监 吉 勇：阿科玛嵌段聚合物技术在增韧领域的应用	
	广东生益科技股份有限公司工程师 范华勇： 低分子量聚酰胺酰亚胺树脂的合成与性能研究	
	四川东材科技集团股份有限公司高级工程师 支肖琼： 低介电苯并噁嗪树脂的合成及性能研究	

	东华大学应用化学系研究生 吴 倩：氧化石墨烯在高导热绝缘材料中的运用	
	山东圣泉新材料股份有限公司经理 刘 耀：芳烷基酚固化环氧树脂的研究	
一楼《多功能1》		
	国家电子电路基材工程技术中心工程师 葛 鹰：国家工程中心测试项目与能力介绍	沈宗华
	President of Essex Technologies Group, Douglas J. Sober: Status of IPC-4101F and Related Topics (IPC-4101F 现状)	
	空间电子信息技术研究院研究员 田步宁：无源互调抑制技术研究	
	苏州生益科技有限公司工程师 任科秘：X/Y 轴热膨胀系数的测试研究	
	国家电子电路基材工程技术研究中心工程师 盘文辉：流变方法分析氰酸酯预聚体及其固化体系的凝胶化	
	上海第二工业大学教授 王景伟：覆铜板固体废弃物的处理与再利用的技术	
18:00~ 20:00	晚宴（一楼 会议2厅）	王 猛 王晓艳

《第四届中国挠性覆铜板企业联谊会》日程及报告安排

时间	报告地点、报告人及报告题目	主持人
	一楼《会议厅10》	
11月10日 上午8:00~10:30	安徽统唯新材料科技有限公司销售总监 年海峰：PI膜产品与技术的新发展	范和平
	中国电子学会电子制造与封装技术分会印制电路专委会 顾问 辜信实： 二层挠性覆铜板制造技术	
	广东生益科技有限公司软性材料部技术总监 伍宏奎：中国软板技术向何处去？	
	华烁科技股份有限公司副研究员 严 辉：绿色可降解挠性覆铜板材料发展概况	
	中国科学院长春应用化学研究所研究生 马平川：涂布法制备柔性无胶覆铜板	
	CCLA 资深顾问 祝大同：挠性印制电路板市场与产业的最新发展	
10:30~12:00	交流研讨	
	会长总结	
12:00~13:30	午餐（一楼 多功能1厅）	王晓艳

会期日程：

2017年11月8日~10日。8日全天报到，9日全天报告，10日上午报告。10日疏散。